



異方導電性接着剤

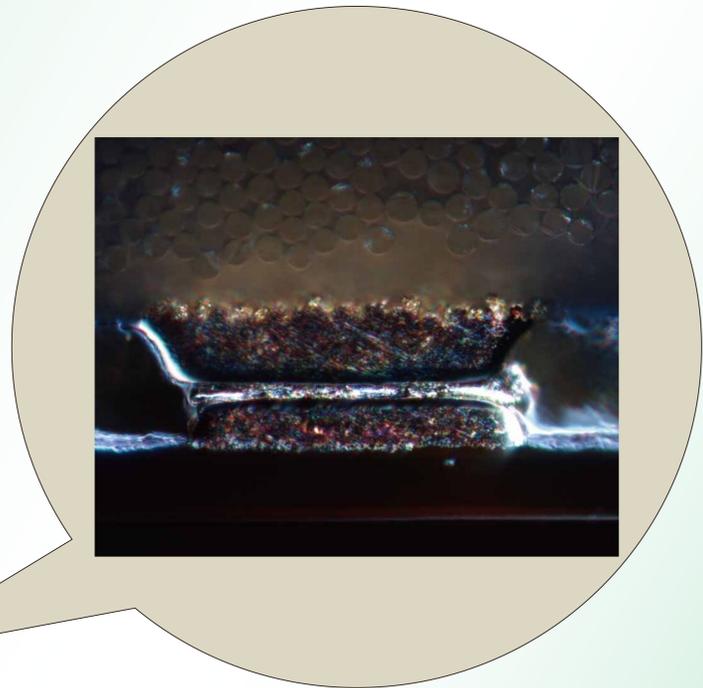
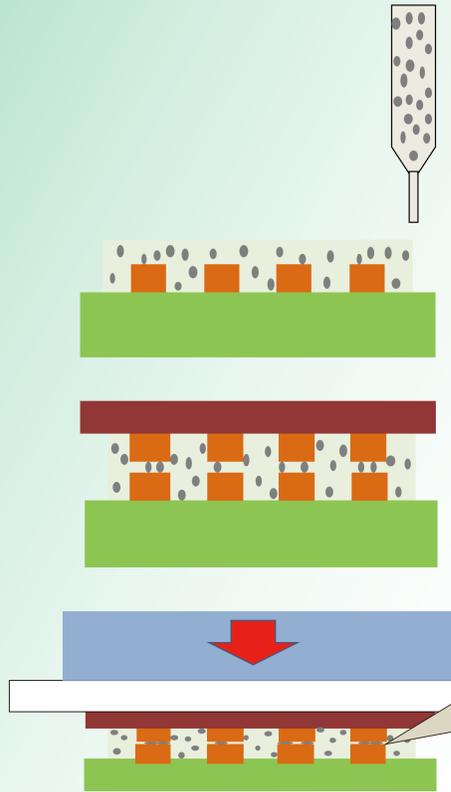
Anisotropic Conductive Adhesives

低温かつ低圧で接続可能な異方導電ペースト
Low pressure connection at low temperature.

塗布
Coating

貼り合わせ
アライメント
Positioning and
alignment

圧着
Press lamination



特徴 Features

- 低温短時間での硬化が可能（150℃ 5秒） Quick cure at low temperature（150deg.C 5sec.）
- 低圧力での接続が可能（0.8MPa） Low pressure connection（0.8MPa）
- 低背接続（0.1mm） Thin connection（0.1mm）
- リペア接続が可能 Easy reworkability

粘度 Viscosity	Pa・s	150
TI		1.3
硬化温度 Curing temp.	℃	150
硬化時間 Curing time	秒	5
圧力 Press.	MPa	0.8
密着強度 Adhesion	90° peel	20N
絶縁性 Insulation resistance	Ω	1.00E+11



本製品は、パナソニック ファクトリーソリューションズ社のライセンスに基づくものです。
This product is licensed by PFSC



TAIYO INK MFG. CO., LTD.